PCB 设计布线要点分析

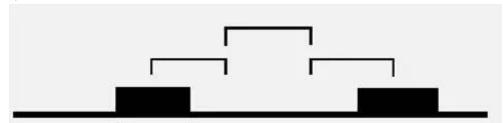
1、布线优先次序要求

- a) 关键信号线优先:电源、摸拟小信号、高速信号、时钟信号和同步信号等关键信号 优先。
- b) 布线密度优先原则:从单板上连接关系最复杂的器件着手布线。从单板上连线最密 集的区域开始布线。
- c) 关键信号处理注意事项:尽量为时钟信号、高频信号、敏感信号等关键信号提供专门的布线层,并保证其最小的回路面积。必要时应采取屏蔽和加大安全间距等方法。 保证信号质量。
- d) 有阻抗控制要求的网络应布置在阻抗控制层上,须避免其信号跨分割。

2、布线窜扰控制

a) 3W 原则释义

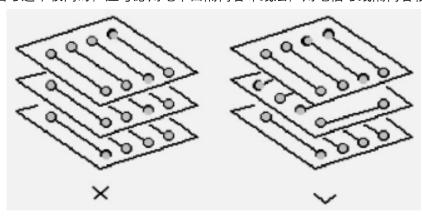
线与线之间的距离保持 3 倍线宽。是为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,如果线中心距不少于 3 倍线宽时,则可保持 70%的线间电场不互相干扰,称为 3W 规则。



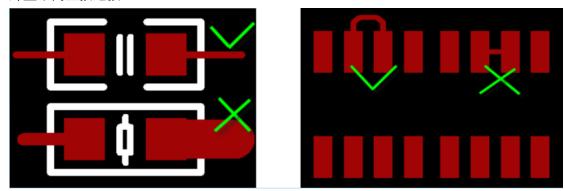
- b) 窜扰控制:串扰(CrossTalk)是指 PCB 上不同网络之间因较长的平行布线引起的相互干扰,主要是由于平行线间的分布电容和分布电感的作用。克服串扰的主要措施是:
 - i. 加大平行布线的间距, 遵循 3W 规则;
 - ii. 在平行线间插入接地的隔离线
 - iii. 减小布线层与地平面的距离。

3、布线的一般规则要求

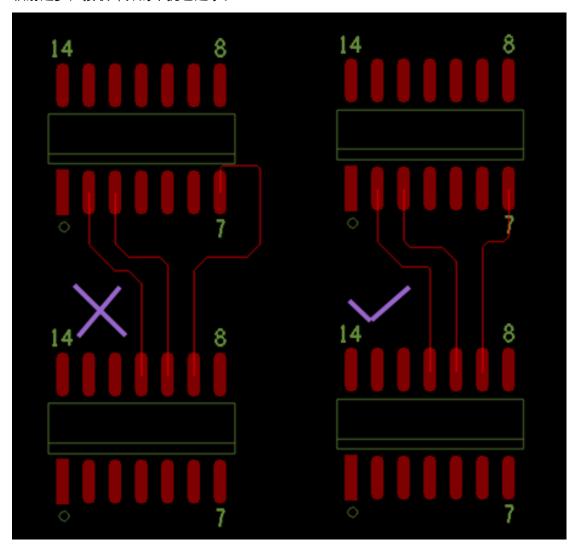
a) 相邻平面走线方向成正交结构。避免将不同的信号线在相邻层走成同一方向,以减少不必要的层间窜扰;当由于板结构限制(如某些背板)难以避免出现该情况,特别是信号速率较高时,应考虑用地平面隔离各布线层,用地信号线隔离各信号线。



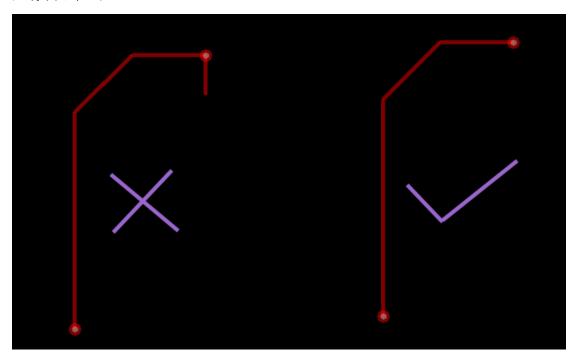
b) 小的分立器件走线须对称,密间距的 SMT 焊盘引线应从焊盘外部连接,不允许在焊盘中间直接连接。



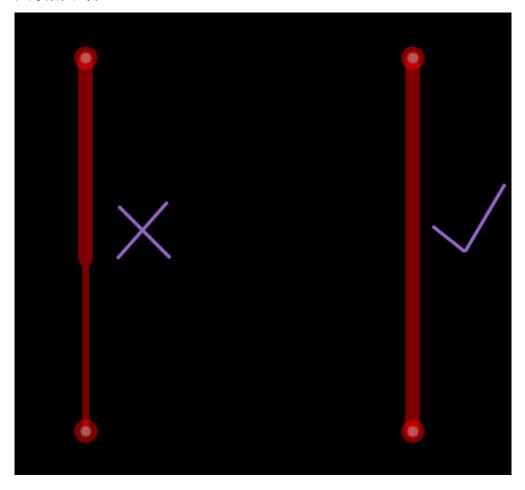
c) 环路最小规则,即信号线与其回路构成的环面积要尽可能小,环面积越小,对外的辐射越少,接收外界的干扰也越小。



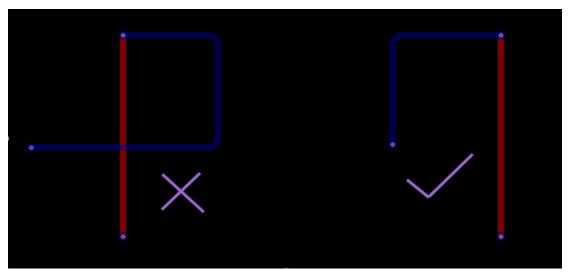
d) 走线不允许出现 STUB。



e) 同一网络的布线宽度应保持一致,线宽的变化会造成线路特性阻抗的不均匀,当传输的速度较高时会产生反射。在某些条件下,如接插件引出线,BGA 封装的引出线类似的结构时,因间距过小可能无法避免线宽的变化,应该尽量减少中间不一致部分的有效长度。



f) 防止信号线在不同层间形成自环。在多层板设计中容易发生此类问题, 自环将引起辐射干扰。



g) PCB 设计中应避免产生锐角和直角,产生不必要的辐射,同时 PCB 生产工艺性能也不好。

